

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-001

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 2024 年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、本期业绩预告情况

##### （一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

##### （二）业绩预告情况

（1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-100,000.00 万元到-84,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少-118,654.28 万元到-102,654.28 万元。

（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将出现亏损，约为-128,000.00 万元到-107,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加-111,405.61 万元到-90,405.61 万元。

#### 二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：17,765.21 万元。归属于母公司所有者的净利润：18,654.28 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-16,594.39 万元。

（二）每股收益：0.068 元。

#### 三、本期业绩变化的主要原因

1. 报告期内，全球半导体市场迎来复苏，根据 WSTS 预测，全球半导体市场规模超过 6,200 亿美元，与上年同期相比增长 19%。但市场复苏从下游向上游传导尚需一定周期，同时受到全球半导体行业高库存水平影响，半导体硅片市场

的复苏不及预期，根据 SEMI 预测，报告期内，全球半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅下跌 2.5%，其中，300mm 半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅微涨 1.4%，200mm 半导体硅片出货面积与上年同期相比继续下跌 12.1%；同时，报告期内全球半导体硅片（含 SOI 硅片）市场规模预计为 133 亿美元，与上年同期相比下跌约 5.6%。公司的经营表现与整体市场情况一致，其中 300mm 半导体硅片的单价虽然由于市场影响和竞争加剧有所下降，但其销量随公司产能提升和市场复苏有较大提升，而 200mm 半导体硅片（含 SOI 硅片）的销量基本持平略有下降，且部分产品的单价受市场影响下降较大。

2. 公司前期并购的子公司 Okmetic OY 和上海新傲科技股份有限公司的主营业务为 200mm 半导体硅片，在报告期内受市场影响较大，出现商誉减值迹象，初步预估商誉减值金额约 3 亿元。

3. 由于公司扩产项目前期投入较大，固定成本较高，且公司始终坚持较高水平的研发投入，短期内也一定程度上影响了公司的业绩表现，但未来随着扩产项目的产能释放和新产品投入量产将有效提升公司的市场竞争力和盈利能力，并有利于公司长期业绩表现。

#### **四、风险提示**

公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，最终评估结果与初步测算结果可能存在一定差异，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、与会计师事务所沟通情况**

本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

#### **六、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年1月18日